

2022年4月12日
株式会社ディー・ディー・エス

モバイル端末で普及する USB Type-C 対応 タッチ型指紋認証ユニット「UBF-Touch® Type-C」をリリース ～モバイルワーク時の本人確認強化に貢献～

指紋認証をはじめとした、さまざまなセキュリティ・ソリューションを提供する株式会社ディー・ディー・エス（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：久保 統義、以下 DDS）は、小型で新認証アルゴリズム*1に対応したタッチ型指紋認証ユニット「UBF-Touch®」に、USB Type-Cに対応した「UBF-Touch® Type-C」を追加し、本日より提供開始することを発表いたします。

モバイルワークの積極活用を通して、業務効率の改善および生産性の向上、ワークライフバランスの実現に取り組む企業や団体が増えております。モバイルワークの導入により、移動中や公共のスペースなど、多くの人が入り出る場所で勤務をすることになり、情報セキュリティのリスク対策が必要です。生体認証を用いた認証ソリューションは、モバイル端末の紛失や盗難、なりすましによる社内情報の漏えいといったセキュリティ課題への対策として有効です。

「UBF-Touch® Type-C」は従来の「UBF-Touch®」同様、タッチ型指紋センサーを採用しており、軽くセンサー部にタッチするだけで認証が可能で、認証時の操作性を高めます。ノートパソコンへの搭載で普及している USB Type-C に対応し、USB の向きや位置・方向などに影響されない指紋の読み取りを可能とし、可用性を大幅に高めております。

DDS 独自開発のタッチ型指紋センサー向けの新認証アルゴリズム*1 を利用することで、「UBF-Touch®」との互換性を持ち、タッチ型指紋センサーでありがちな、指紋の読み取り範囲が狭域になることによる認証精度の低下や、偽造指防止対策の困難さを招く懸念へも対応しています。

「UBF-Touch® Type-C」は、自治体や企業に展開する、利便性と安全性に優れた DDS の認証ソリューションとあわせて利用することで、他の認証要素と組み合わせた二要素認証（多要素認証）や、ログの一括管理によるセキュリティリスクの低減を実現します。

DDS はこの度のリリースにより、企業や団体による新しい働き方への取り組みの支援を推進するとともに、モバイル端末の認証市場においても確固たるポジションを確立してまいります。

なお、当発表において DDS の 2022 年 12 月期の連結業績に与える影響は軽微であります。

*1 新認証アルゴリズムでは、従来の数十倍の情報量を利用した詳細な認証処理により、スワイプ型指紋センサーと同等の認証精度を確保しています。また、PAD（Presentation Attack Detection：提示型攻撃検知）の対策として、LBP（Local Binary Pattern）などに代表される複数の画像認識技術をベースとした DDS 独自の攻撃耐性や偽造指防止対策を提供し、本ハードウェアの持つ可用性（認証の容易さ、認証動作の素早さなど）を損なうことなく、高い認証精度と安全性を実現しています。

≪ 「UBF-Touch® Type-C」 の概要 ≫

型番	UB-HC01
外形寸法	21.4mm(L)×21.1mm(W)×8.4mm(H)
質量	6.5g
指紋センサー	ELAN eFSA614RA
インターフェース	USB 2.0
供給電力	USB Bus Power
消費電力	12mA
対応規格	VCCI(class B), RoHS, CE



タッチ型指紋認証ユニット「UBF-Touch® Type-C」

≪ 「UBF-Touch® Type-C」 が利用可能な認証基盤の概要 ≫

■ 万能認証基盤 Themis

「Themis (テミス)」は、各種システムに対するパスワードでの本人認証を生体（指紋、顔、指静脈、手のひら静脈）、IC カード（FeliCa、MIFARE）、パスワードを用いた多要素認証方式に置き換える認証基盤です。Windows ログオン認証（マルチテナント構成に対応）、アプリ認証、SAML 連携認証に加え、Chrome OS へのログイン認証など、幅広いシステムの認証に対応しています。

（ホームページ：<https://www.dds.co.jp/ja/product/3314/>）

■ 多要素認証基盤 EVE MA

「EVE MA (イヴエムエー)」は、各種システムに対するパスワードでの本人認証を生体（指紋、顔、静脈）、IC カード（FeliCa、MIFARE、マイナンバーカード）、パスワードを用いた多要素認証方式に置き換える認証基盤です。Active Directory とのシームレスな連携で組織・グループに対する柔軟な設定を可能とし、エンタープライズシステムの認証基盤における自在な設定を可能にします。

（ホームページ：<https://www.dds.co.jp/ja/product/3199/>）

■ 二要素認証基盤 EVE FA

「EVE FA (イヴエフエー)」は、Active Directory で管理された端末及びワークグループ利用の端末に対して、Windows ログオンや業務アプリの認証、仮想デスクトップでの認証を、指紋認証、IC カード認証などの二要素認証に置き換え、さまざまな業務環境に対して安全で利用しやすいシステム環境を提供します。

（ホームページ：<https://www.dds.co.jp/ja/product/16/>）

《株式会社ディー・ディー・エスについて》

DDS は、指紋認証ソリューションのリーディングカンパニーとして創業以来、産学連携による技術開発に積極的に取り組んでおります。多様化する情報セキュリティ・ソリューション・ニーズに対応可能な「万能認証基盤 Themis」、「多要素認証基盤 EVE MA」および「二要素認証基盤 EVE FA」などの情報セキュリティ製品の開発・販売を行っております。

2014年4月、オンライン認証の標準化団体である FIDO (Fast IDentity Online) アライアンスに、国内企業として初めて加入。2015年10月に、FIDO 認定製品である指紋認証デバイス“magatama®”を発表、2017年5月より、生体認証を活用した認証システムの構築を実現する「マガタマプラットフォーム」を提供、本人認証の世界を広げる新しい認証サービスの普及に努めております。また、ブロックチェーン技術の認証系市場での活用研究も進めております。

(ホームページ：<https://www.dds.co.jp/ja/>)

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ディー・ディー・エス

担当：営業本部 販売促進部 販売促進課

Email：sales@dds.co.jp

※プレスリリースに記載されているロゴ、会社名、製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

※プレスリリースに掲載されている内容、製品・サービスの価格、仕様、お問い合わせ先、その他の情報は、発表時点の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。また、プレスリリースにおける計画、目標などはさまざまなリスクおよび不確実な事実により、実際の結果が予測と異なる場合もあります。あらかじめご了承ください。